

車載組込みシステムフォーラム 2022

主催：車載組込みシステムフォーラム（ASIF）
共催：名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所
後援（予定）：一般社団法人組込みシステム技術協会 中部支部
組込みシステム産業振興機構
NPO法人TOPPERSプロジェクト
公益社団法人自動車技術会

車載組込みシステムフォーラム（ASIF：Automotive Embedded System Industry Forum）は、東海地区の車載組込みソフトウェア産業を発展させることを目的として、2008年4月1日に設立されました。勉強会、スキルアップセミナー、応用技術セミナーなど、人材や企業の育成のための活動を実施しています。今般、広く組込みシステムに関連する方々を対象として、車載組込みシステム技術に関する最新動向などの情報共有と、関係企業等の交流を目的としたフォーラムを開催します。

日時

2022年1月31日（月）
10:00～16:40

開催方法

会場・オンライン開催（事前申込制・先着順）

申込期限：2022年1月24日（月）

会場参加方法

ナディアパーク デザインセンタービル3階
デザインホール

定員100名

名古屋市中区栄三丁目18番1号

- 交通案内・名古屋市地下鉄名城線「矢場町」駅 5・6番出口 徒歩5分
・名古屋市地下鉄東山線「栄」駅 7・8番出口 徒歩7分

■URL：<http://www.nadiapark.jp/>



下記の「会場参加」申込フォームからお申し込みください。

<https://www.secure-cloud.jp/sf/1636007691fWkOQZVN>

申込後、登録いただいたメールアドレスへ自動返信で受付票が送付されます。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、感染拡大防止のため、急遽オンライン参加に変更とさせていただきます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

オンライン参加方法

Zoom Webinar

定員400名

配信は当日のみアーカイブはなし

下記の「オンライン参加」申込フォームからお申し込みください。

<https://www.secure-cloud.jp/sf/1481694203YeEmoYIP>

申込後、登録いただいたメールアドレスへ自動返信で受付票が送付されます。

申込締切後、開催2日前までに接続先URLをメールでお送りします。

参加費

ASIF会員

名古屋大学 未来社会創造機構
モビリティ社会研究所 関係者
無料

後援団体会員

2,500円（消費税込）

非会員

5,000円（消費税込）

参加費は、別途連絡する銀行口座にお振込みください

車載組込みシステムフォーラム（ASIF）

<http://www.as-if.jp>



プログラム

ASIF活動紹介

10:00-10:40 「**車載組込みシステム開発の現状とASIFの活動**」

車載組込みシステムフォーラム会長
名古屋大学 大学院情報学研究科
附属組込みシステム研究センター長 教授

高田 広章

概要：車載組込みシステム業界における開発の現状に関する話題提供とASIFの活動状況紹介

専門セミナー 1

10:45-11:45 「**クルマを取り巻くセキュリティとJ-Auto-ISACの活動紹介**」

一般社団法人Japan Automotive ISAC（マツダ株式会社）
技術委員会 委員長

山崎 雅史 氏

概要：クルマを取り巻くセキュリティについて最新の法規・標準動向を踏まえた業界としての取組みを紹介するとともにその代表的な動きである一般社団法人J-Auto-ISACの設立背景や活動内容について紹介する。

専門セミナー 2

13:15-14:15 「**車載電子部品BCPの業界標準ガイドライン**」

公益社団法人自動車技術会
電子・電装部会 自動車用半導体分科会 分科会長

若林 哲明 氏

概要：車載電子部品はCASE対応にて加速的に採用増加し、自動車の商品性を担う重要な部品となっている一方で、突発的な災害や世界規模の需給バランスの乱れに際し、自動車の生産継続には効率的な部品切替が要求される。本講演では、この電子部品の切替の効率的な手法として、自動車技術会で進めている標準化活動を紹介する。

専門セミナー 3

14:20-15:20 「**半導体の供給不足の現状と今後の見通し**」

ネットグラフサービス株式会社 代表取締役

三好 文明 氏

概要：20年後半より、自動車向けをはじめとして、半導体の供給不足が話題となった。米中貿易摩擦や、新型コロナウイルスの感染拡大によるリモートワークやオンライン学習の普及など電子機器の市場と半導体の市場動向に大きな変化がみられるようになってきている。こうしたことから、半導体の供給不足の要因となっている需要と、メーカーの供給対応など、今後の見通しについて、解説する。

基調講演

15:40-16:40 「**自動車業界の変化とソニーの取り組み**」

ソニーグループ株式会社 執行役員

大村 隆司 氏

概要：現在、モビリティ分野は、コロナ禍、環境課題によってCASEの進化が、加速。本講演では、その進化をとらえて、ソニーのモビリティに対する取り組みや、今後、New Normal時代において、「遠隔、非対面、非接触」が重要な課題となる中、DXの進化と共にセンシングデバイス、重要なキーデバイスになることをお伝えする。

